

# **LP 5720**



Page 1

# Crème à braser sans plomb, sans halogènes et sans nettoyage

## Description

La crème à braser **LP 5720** est une crème sans nettoyage, absolument sans halogènes et sans plomb qui a été développée pour une meilleure stabilité sur le pochoir et résidus transparents après la refusion

La crème à braser garde ses propriétés rhéologiques dans une grande fenêtre de conditions atmosphériques ce qui garantit un process de sérigraphie stable et répétitif.

La crème à braser **LP 5720** est appropriée pour des profils de refusion longs et courts ainsi que pour les profils hauts et bas.

Les résidus après la refusion sont transparents et très peu, aussi avec des profils de refusion longs et hauts.

Les résidus sont compatibles avec le test 'in situ'.

La crème à braser **LP 5720** fait preuve d'un 'voiding' acceptable.

La crème est absolument sans halogènes ce qui garanti une fiabilité supérieure après le brasage.

La crème à braser est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle

# RoHS

# **Avantages**

- Grande stabilité et temps de vie sur le pochoir
- Large fenêtre de process en refusion
- Peu de résidu transparent
- Absolument sans halogènes

# Disponibilité

alliages	
Sn96,5Ag3Cu0,5	
Sn99Ag0,3Cu0,7	
Sn99,3Cu0,7	

Autres alliages sur demande

Fiche Technique LP 5720

Ver: 4.2 04-04-17

pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
sérigraphie:	type 3	pot :250g/500g
~ 88.5%	type 4	cartouche:
		60z: 500g/600g/700g
	type 5 pour certains alliages	12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg seringue: 5CC/10CC/30CC
		autres conditionnements sur demande

S.A. INTERFLUX<sup>®</sup> ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970

tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970 www.interflux.com - Info@interflux.com





# Technical data LP 5720



Page 2

# Recommendations pour le profil de refusion de la LP 5720

La crème à braser LP 5720 a été développée pour une large fenêtre de process en refusion. Elle est appropriée pour des profils de refusion longs et courts ainsi que pour les profils hauts et bas.

En général un profil de refusion avec un palier court est recommandé. Des profils de type linéaire ou avec un palier sont également possibles. .Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer ou éliminer la présence de « voids ».

Pendant la refusion sans plomb, il faut être attentif de ne pas surchauffer les composants, surtout avec les fours de type convection et infrarouge. Il est très important de connaître les limitations de température des composants du circuit. Pour avoir une bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, utilisez des thermocouples pour enregistrer les températures. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en température. Mesurez sur les côtés, au milieu et à proximité du convoyeur et de grandes masses thermiques.

#### **Préchauffage**

Afin de permettre l'évaporation de l'humidité absorbée et d'éviter les composants de craquer, maintenir une pente entre 1-3°C/s jusqu' à environ 200°C. Pour ça éviter des températures de convection dans la première zone supérieure a 150°C.

#### **Palier**

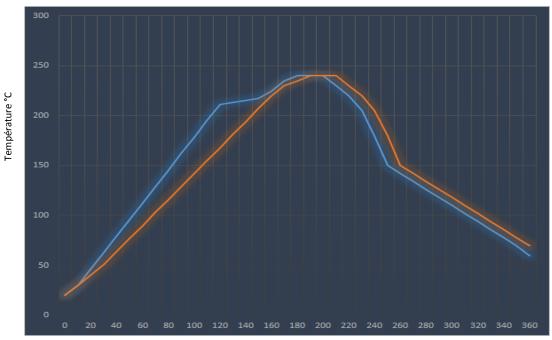
Un palier entre 200°C et 215°C peut être utilisé afin de limiter les différences de températures du circuit ou bien, pour diminuer la présence de « voids ».

#### Refusion

Le pic de refusion est limité par les spécifications des composants. En général entre 235°C and 250°C. Le temps au-dessus du liquidus (au-dessus du point de fusion) est en général entre 45 et 90s.

#### Refroidissement

Pas plus vite que - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des matériaux (composants et circuits). En général un refroidissement rapide donne des joints de soudure plus fortes.



Temps en secondes





# Technical data LP 5720



Page 3

# Manipulation

## **Stockage**

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° - 7°C. Temps de stockage : 6 mois.

#### **Manipulation**

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

## <u>Sérigraphie</u>

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. Il est recommandé de presser le circuit dans le pochoir entre 0,2 en 0,4mm. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalle régulier.

## **Entretien**

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage ISC8020 est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

## **Réutilisation**

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

# Résultats des tests de fiabilité Conforme à la norme IPC J-STD-004B/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.32D
Argent chromate (CI, Br)	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.33D
Test tache (F)	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.35.1
Test de corrosion	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.15
Classification du flux	RO LO	J-STD-004B
Test d'étalement	99,89 mm²	J-STD-004B 2.4.46
Environnement Test SIR	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.3.7

Propriétés		Résultats	Méthodes
Mécanique			
Test de microbilles	après 15min	passe	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	après 4h	passe	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage		passe	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	après 15min à 25°C	passe	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	après 10min à 150°C	passe	J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35



Fiche Technique LP 5720



# Technical data LP 5720



Santé et Sécurité

Page 4

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

# Recommandations et paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse: 10—100 mm/sec
Pression sur les racles: 250g—350g/cm
Intervalle de nettoyage du pochoir: chaque 10 circuits
Température souhaitée: 15 to 25°C
Humidité souhaitée 40% to 75% r.H.
Temps de vie sur le pochoir: >24hrs

**Assemblage CMS** 

Durée du pouvoir collant ('tack time'): >8 heures

Refusion

Profil: linéaire, palier Type de four: convection, ...

Test "in situ":

appropriée pour: "flying probe" Planche à clous

Nettoyage

Le nettoyage de la crème des pochoirs et des racles est recommandé avec Interflux<sup>®</sup> **ISC 8020.** 

Les résidus après refusion de la crème LP 5720 sont très fiables et n'ont pas besoin de nettoyage, mais ils peuvent être nettoyés si cela est désirable.

Nom commercial du produit : LP 5720 No-Clean, Halide Free, Lead-Free Solder Paste

## CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

#### Copyright:

**INTERFLUX** ELECTRONICS N.V.

Fiche Technique LP 5720

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com

ISO 9001

S.A. INTERFLUX<sup>®</sup> ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970

Ver: 4.2 04-04-17 www.interflux.com - Info@interflux.com